

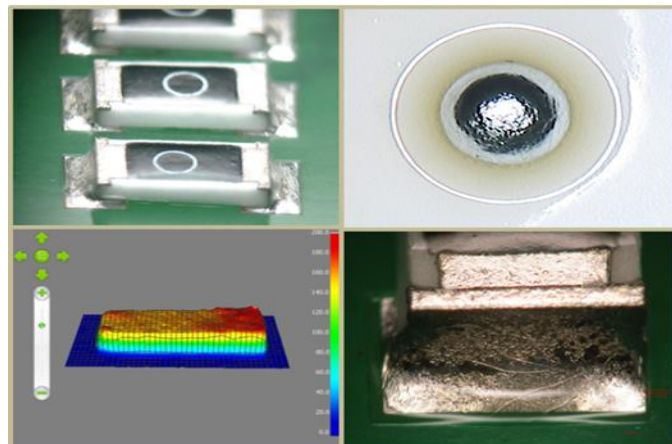
## NC259 T6 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN

### CARACTERÍSTICAS

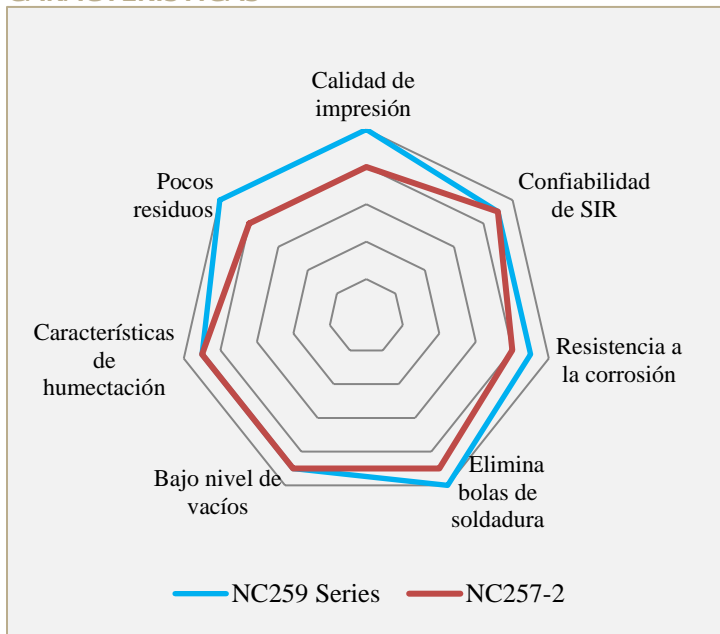
- Residuos extremadamente bajos
- Duración de la impresión de 8 horas
- Capacidad de reflujo de nitrógeno
- Capacidad de impresión de <0.66AR
- Alta adherencia

### DESCRIPCIÓN

Las pastas de soldadura NC259 de la serie T6 de AIM son compatibles con SAC y aleación sin/con poca plata. La serie NC259 demuestra capacidad de pausa de impresión y de impresión de más de 8 horas, mientras que proporciona una alta eficiencia de transferencia y precisión en la definición de la impresión. El exclusivo sistema activador promueve mojado incluso en ausencia de plata y tolera picos de reflujo de temperaturas tan altos como 260°C.



### CARACTERÍSTICAS



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Hora	Temperatura
Vida útil en refrigeración	3 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)

NC259 Serie T6 debe consumirse dentro de las 24 horas después de que se rompa el sello del envase. La pasta puede permanecer en la impresora durante 6-8 horas, un periodo más largo es aceptable según el rendimiento de la impresión y el reflujo. No añada pasta usada a la pasta sin utilizar. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta nueva bien sellada con el tapón interno o la tapa en su lugar. Consulte la guía de manejo de soldadura en pasta de AIM para más información. Las condiciones de la aleación y almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el certificado de análisis de la serie NC259 para obtener información específica del producto. Recomendaciones adicionales de manipulación se pueden encontrar en [https://aimsolder.com/sites/default/files/aim\\_paste\\_handling\\_guideline\\_sp\\_revnf1.pdf](https://aimsolder.com/sites/default/files/aim_paste_handling_guideline_sp_revnf1.pdf)

### LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura NC259 del estencil durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de estenciles. DJAW-10 no secará la pasta NC259 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final del estencil.




Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de NC259 pueden permanecer en el ensamblaje después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria

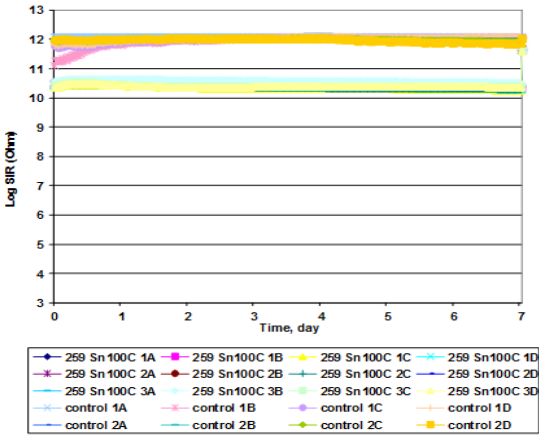
para asegurarse de que los residuos de NC259 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de flux comunes. Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.

## PERFIL DE REFLUJO



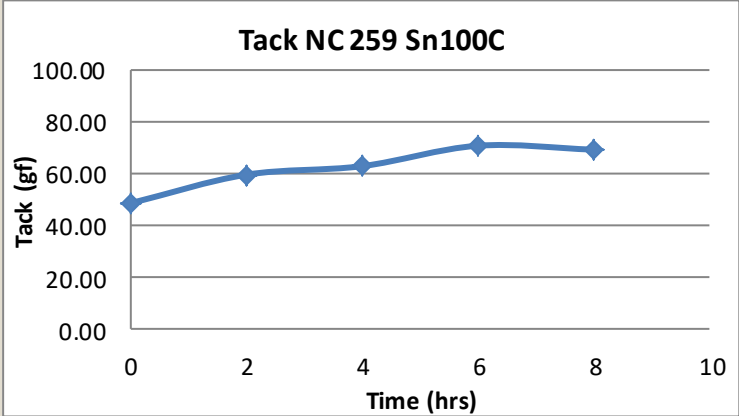
Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

## DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC	J-STD-004	ROL0	
Clasificación IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Haluros cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	PASA	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Sólidos del fundente, determinación de no volátiles	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	95.6% Típico	
Valor Ácido Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	150 +/- 4 mg KOH/ g flux Típico	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34 Malcom	150-350 PaS	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	500 - 1000 Kcps	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	

Prueba de Slump de la Soldadura en Pasta	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
--	-------------------------------------	------	--

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen												
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>15 min</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4 Horas</p>  </div> </div>												
Fuerza de Adhesión	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	48gf Típico	<div style="text-align: center;">  <p><b>Tack NC 259 Sn100C</b></p> <table border="1"> <caption>Tack (gf) vs Time (hrs)</caption> <thead> <tr> <th>Time (hrs)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>48</td></tr> <tr><td>2</td><td>60</td></tr> <tr><td>4</td><td>62</td></tr> <tr><td>6</td><td>70</td></tr> <tr><td>8</td><td>68</td></tr> </tbody> </table> </div>	Time (hrs)	Tack (gf)	0	48	2	60	4	62	6	70	8	68
Time (hrs)	Tack (gf)														
0	48														
2	60														
4	62														
6	70														
8	68														
Prueba de Wetting	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA													

+ Toda la información es sólo para referencia. No deben utilizarse como especificaciones de productos entrantes ni para el diseño de procesos. Consulte el certificado de análisis para obtener información específica del producto.